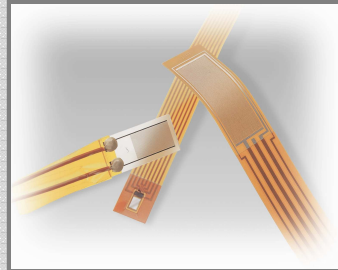
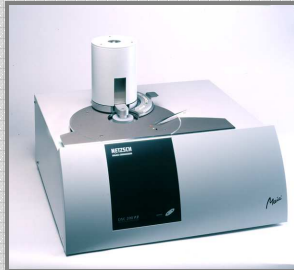


Comunicado de Prensa



- Cómo de elevada es la conductividad térmica del componente electrónico?
- Está la capa de unión del chip suficientemente curada?
- A qué temperatura se funde el soldador sin plomo?

La unidad de negocio de Analyzing & Testing de NETZSCH puede responder a éstas y similares preguntas en el campo de análisis térmico y propiedades termofísicas. En Productronica 2007, en Munich, se presentarán las técnicas instrumentales más novedosas adaptadas a la industria electrónica:

DSC 200 **F3 Maia**[®] con intercambiador automático de muestras para análisis de transiciones vítreas, fusiones, cristalizaciones, reacciones, calores específicos y estabilidades de oxidación.

DEA 230/231 **Epsilon** con distintos tipos de sensores para el análisis del comportamiento de curado de varias resinas reactivas, adhesivos y recubrimientos – también on-line.

LFA 447 **NanoFlash**[®] para la determinación de la conductividad térmica – también para componentes multicapa y anisotrópicos.

Venga a visitarnos en el salón B5, en el stand compartido con Bayern Innovativ No. 161; estaremos encantados de hablar con usted sobre sus requerimientos para aplicaciones en desarrollo de producto, garantía de calidad, análisis de errores y optimización de procesos!

NETZSCH-Gerätebau GmbH
BU „Analyzing & Testing“
Wittelsbacherstraße 42
95100 Selb/ Germany

Phone: +49 9287 881 110
Fax: +49 9287 881 505
E-mail: at@netsch.com

www.netsch-thermal-analysis.com